

Caneta De Sucção A Vácuo De Alta Precisão Em Peek Seguro Para ESD Para Manuseio De Substratos Semicondutores E Fotovoltaicos De 8 Polegadas

Número do item: PL-CP115



introdução

Caneta de sucção a vácuo de wafer em PEEK de alto desempenho e segura para ESD, projetada para manuseio de precisão de wafers semicondutores e fotovoltaicos de 8 polegadas. Esta solução personalizável oferece superior resistência química e durabilidade mecânica para ambientes críticos de sala limpa e processos delicados de transferência de substratos.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Inspeção de Wafer	Transferência manual de wafers de silício de 8 polegadas de e para estações de inspeção óptica ou SEM.	Área de contato mínima reduz o risco de geração de defeitos superficiais.
Classificação de Células Fotovoltaicas	Manuseio e classificação de células solares de alta eficiência durante as fases de montagem e teste.	Evita microfissuras e mantém a eficiência da célula através de uma aderência a vácuo suave.
Processamento em Mesa Úmida	Transferência de substratos entre banhos químicos ou estações de enxágue em ambientes de química úmida.	Resistência excepcional a produtos químicos de processo agressivos e umidade.
Deposição de Filme Fino	Colocação e remoção de substratos de câmaras de vácuo PVD/CVD ou load locks.	A alta estabilidade térmica permite o manuseio após ciclos de deposição de alta temperatura.
P&D em Sala Limpa	Manuseio geral de substratos em instalações de pesquisa e desenvolvimento de materiais avançados.	Mantém padrões rigorosos de limpeza ISO minimizando a liberação de partículas.
Preparação para Die Bonding	Posicionamento manual de wafers para corte ou operações subsequentes de die bonding.	Propriedades seguras para ESD evitam defeitos latentes em microcircuitos sensíveis.
Manuseio de Substrato LED	Manipulação de precisão de substratos de safira ou SiC durante a fabricação de chips LED.	Aderência segura em superfícies polidas e duras sem deslizamento ou arranhões.

Categoria de Especificação	Detalhe da Especificação PL-CP115
Identificação do Modelo	Série PL-CP115
Material Principal	PEEK Seguro para ESD de Alto Desempenho
Compatibilidade de Substrato	Totalmente Personalizável (Otimizado para wafers de 8 polegadas/200mm)
Resistência Superficial	Personalizável para faixas seguras especificadas de ESD (ex: 10^6 - 10^9 Ω)
Faixa de Temperatura de Operação	Personalizada com base nos requisitos do processo
Compatibilidade Química	Universal (Altamente resistente à maioria dos ácidos, bases e solventes)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Categoria de Especificação	Detalhe da Especificação PL-CP115	
Tipo de Conexão de Vácuo	Dimensionamento sob medida para corresponder às linhas de vácuo da instalação ou bombas portáteis	
Configuração da Ponta	Formas personalizadas (plana, curva, multiponto) disponíveis mediante solicitação	
Classificação de Sala Limpa	Compatível com Classe ISO 3 - 8 (Dependente da aplicação)	
Método de Fabricação	Usinagem CNC de Precisão para Especificações Sob Medida	
Dimensões do Cabo	Ergonomicamente adaptado às preferências do cliente	